

新闻稿

日期：2012 年 3 月 16 日

华润微电子荣膺“2011 年度中国十大半导体制造企业” 三项产品技术获中国半导体创新产品与技术奖

华润微电子有限公司（以下简称“华润微电子”）在 2012 年 3 月 15 日“2012 年中国半导体市场年会暨集成电路产业创新大会”上，荣膺“2011 年度中国十大半导体制造企业”称号，旗下无锡华润上华半导体有限公司获得了“2011 年度中国半导体节能芯片代工市场年度成功企业”荣誉，公司《绿色电源单片集成超高压 BCD 系列工艺技术》、《6 英寸薄片双极高压功率器件制造技术》、《FCTQFN/FCSOP 先进封装产品技术》三项产品技术获“第六届（2011 年度）中国半导体创新产品与技术奖”。据悉，华润微电子是本次唯一同时获得三项“创新产品与技术奖”的企业。华润微电子首席执行官邓茂松先生受邀在高峰论坛上发言，旗下附属企业华润上华在“智能能源趋势与半导体产品机遇”分论坛上发表了题为《特色模拟工艺服务中国热点市场》的演讲。

华润微电子旗下附属企业华润上华于国内率先开发成功“绿色电源单片集成超高压 BCD 系列工艺技术”并实现量产，为国内唯一提供自主知识产权工艺平台的企业。该应用包含 AC/DC 电源适配器、LED 灯驱动等大多数绿色电源产品、高压桥式驱动电路，以及单片式集成小功率 IPM 模块等目前主流智能功率 IC 的需求。该高压 BCD 系列工艺技术已申请大量专利，并获全球多家客户认定，实现显著量产效益。

旗下华润华晶开发的“6 英寸薄片双极高压功率器件制造技术”，采用三重扩散硅单晶片流通生产，从器件制造流程的第一步到最后芯片组装，厚度仅为 250 μm 。该技术被广泛应用在电子节能照明和绿色电源等领域；同时也带动了国内 6 英寸直拉硅单晶材料的发展，为国内同行打开了 6 英寸薄片规模化生产的可行性并得到实践验证。

旗下华润安盛开发的“FCTQFN/FCSOP 先进封装产品技术”已达到国际先进水平，可以使用在 TQFN 和 SOP 不同封装形式的产品上，满足可靠性及客户对产品实际加工的需求，主要应用在便携式消费类电子产品、RF 功率发射电子产品、电子充电器产品。该技术已形成完整的技术文件和规范，同时申请了专利，封装的产品通过客户考核，并实现工艺定型，进入小批量生产。

华润微电子首席执行官邓茂松先生在高峰论坛和接受媒体采访时表示，华润微电子产品和技术创新的目的，是为了追求企业更有质量的成长，这次公司得奖的三个项目，体现了华润微电子在这种理念指导下产品技术创新和企业管理模式创新的探索成果。邓茂松表示，要借助最近政府出台《集成电路产业“十二五”发展规划》的东风，进一步做强公司芯片设计业务，开发高性能集成电路产品，强化公司开放式晶圆代工业务的服务水平和 IP，提升特色化封测业务的层次和能力，致力于将华润微电子打造成为“中国绿色节能半导体产品的领导者”。

■ 关于华润微电子

华润微电子有限公司是华润集团旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业，亦是中国本土规模和影响力最大的综合性微电子企业之一，连续 7 年被国家工业和信息化部评为中国电子信息百强企业之一。公司以振兴民族微电子产业为己任，矢志成为中国本土最具竞争力的半导体公司。公司为中国内地领先的模拟半导体公司，其业务包括开放式晶圆代工、集成电路设计、集成电路测试封装及分立器件。拥有 5-8 英寸晶圆生产线 5 条，年产晶圆 350 余万片，是国内半导体产业链最为齐全的企业。

华润微电子成立于 2000 年，2002 年收购国内最大的微电子企业华晶集团，成为华润旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的企业，并于 2003 年启动 6 英寸晶圆生产线建设项目；于 2006 年与新加坡 STATS Chi pPAC 合作发展集成电



路封测业务；于 2007 年启动 8 英寸晶圆生产线建设项目，并于 2009 年落成投产，是国内唯一依托自有资金、技术和市场建立的最高技术水平的晶圆生产线；2011 年起实施“走出去”战略，设立台湾窗口公司，在美国硅谷投资设立集成电路设计公司。

传媒垂询：

华润微电子有限公司

吴东妮

电话： (+86-510) 8580 7123-2716

手机： (+86) 1586 1580 806

传真： (+86-510) 8580 4647

电子邮箱： wudn@crmi.cro.com

蒋 艳

电话： (+86-510) 8811 5064

手机： (+86) 1396 1855 032

传真： (+86-510) 8811 5555 ext.5604

电子邮箱： jiangy@csmc.crimi.cro.com